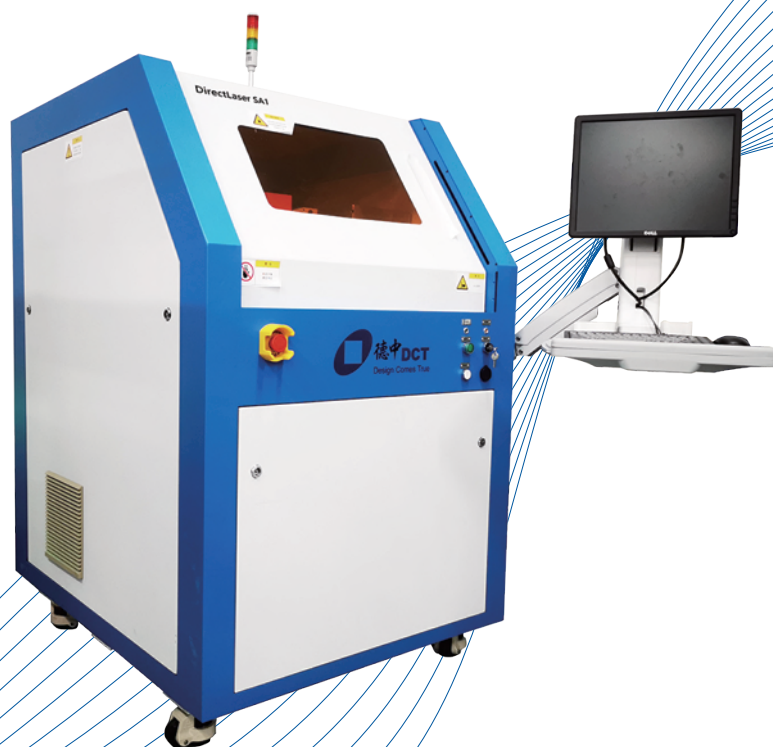
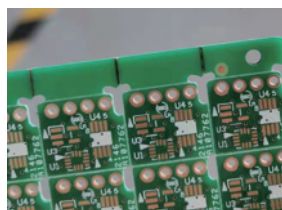
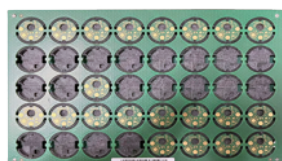


# 德中DirectLaser SA1/SA2 SMT分板利器，小幅面激光精密切割系统

Small platform-Precise laser cutting system

SA1-小快灵，应对多种材料加工，树立性价比新标尺

SA2-高标准，精度效率双管齐下，小幅面设备新标准



- 直接数据驱动，快速导入，产品切换迅速
- 激光替代模具，按需加工，突破机械极限
- 精确激光控制，工艺融合，精度效率并重
- 模块设计组装，结构紧凑，拓展维护便捷
- 操作简单快捷，引导操作，迅速导入生产

电子技术的发展日新月异，元器件装配朝着高密度、高精度、多样化不断发展，激光分板凭借无接触、无应力、高精度、可加工任意形状等优势成为了SMT分板发展趋势。德中多年来深耕电子行业激光加工应用，为SMT分板提供专业设备及全套解决方案。

### 模块化设计组装

机台、激光模块化设计组装，激光多自由度选择，根据材料特性和加工质量要求，可配置多种波长（紫外、绿光等）及脉宽（纳秒、皮秒等）激光器。

### 适应多种应用场景

不止适合于各种厚度的软板、硬板、软硬结合板精密切割钻孔，也适合其他材料如：玻璃、陶瓷、薄金属板等材料的切割钻孔，还可激光直接成型电路板、修工艺导线等。

### 业内独有数据处理软件 CircuitCAM Laser

30年历史，为直接加工技术的发展奠定了基础，装机量远超万套；Laser版本横空出世：可满足激光精密切割、激光钻孔等各类激光加工应用，可自动生成激光加工路径，配备组合加工方案可以根据需求进行激光参数、加工路径的优化选择，明显提升加工质量和速度，减少生产流程，降低成本。

### “速度—效率—精度”三者兼顾

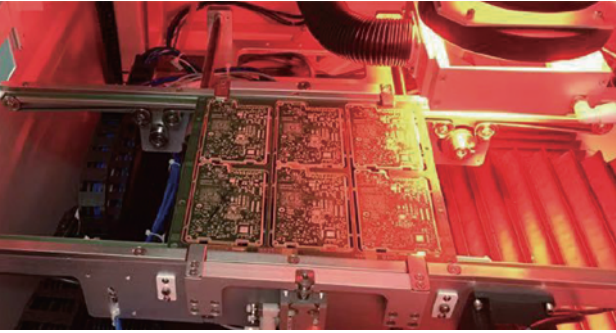
高速运动控制系统配合CCD对位系统，保证加工过程高速高精度加工；融合完备精度校准体系，根据机型和配置不同，辅以涨缩、高度、功率补偿等，突破极限，又快又准。

### 专有分板清洁加工工艺

独创“激光边缘重塑（LBR）”技术，结合了高精度硬件平台和强大软件辅助制造技术，通过特有加工路径规划和精确参数调控，专用于切割边缘清洁处理。

### 智能+安全，智能工厂标配

系统设置了标准工业接口，可集成到MES系统中，它支持操作数据的采集、机器分配、产品跟踪及配送。加工中区域全封闭，保证加工过程的安全防护；可选配多种自动化上下料，构成微型生产线。



技术参数	DirectLaser SA1	DirectLaser SA2
最大加工区域	350mm × 350mm	350mm × 350mm
设备平台	钢架平台, 伺服电机	大理石平台, 直线电机
激光器	飞秒、纳秒、红外、紫外、绿光可选	飞秒、纳秒、红外、紫外、绿光可选
X/Y/Z轴移动分辨率	1μm	1μm
重复定位精度	±2μm	±2μm
数据处理软件	CircuitCAM7 Laser	CircuitCAM7 Laser
设备驱动软件	DreamCreaTor3	DreamCreaTor3
自动上下料系统	标配	标配
摄像头靶标对位系统	标配	标配
工业吸尘系统	选配	选配
设备尺寸 (W × H × D)	1,050mm × 1,600mm × 1,270mm	1,050mm × 1,600mm × 1,207mm
设备重量	600kg	700kg
电源	380VAC/50Hz, 3.0kW	380VAC/50Hz, 3.0kW
环境温度	22℃±2℃	22℃±2℃

参数更改，恕不另行通知



德中（苏州）激光技术有限公司

苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊A幢3楼05/06单元 Tel.: 0512 81880599 Fax: 0512 81880600

德中（天津）技术发展股份有限公司

天津市西青区海泰华科一路11号C座 Tel.: 022 83726901 Fax: 022 83726903

Http://www.dct-china.cn Email:sales@dct-china.cn